

<<电子设计自动化技术>>

图书基本信息

书名：<<电子设计自动化技术>>

13位ISBN编号：9787111138594

10位ISBN编号：7111138597

出版时间：2004-1

出版时间：机械工业出版社

作者：臧春华

页数：247

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子设计自动化技术>>

内容概要

本书不局限于EDA软件的介绍与使用，而是注重EDA技术的系统性与广泛性，从理论、方法到工具进行了较为全面的阐述。

主要内容包括模拟与数字电路仿真原理、模拟与数字可编程器件、印制电路板设计原理以及专用集成电路设计技术，并从实用角度介绍了相关EDA工具Multisim、MAX+plusII、PAC-Designer、Protel 99和Microwind的使用方法，使读者能全面了解和掌握EDA的常用技术与工具。

本书可作为高等院校通信与信息工程专业及其他相近专业的教材，也可作为相关工程技术人员的实用参考书和培训教材。

<<电子设计自动化技术>>

书籍目录

出版说明前言引论第1篇 电子电路的信真技术 第1章 计算机辅助电路分析 1.1 模拟电路仿真原理 1.2 数字电路的逻辑模拟 1.3 数模混合仿真技术 1.4 常用的电路级仿真工具与半导体元器件模型 1.5 习题 第2章 电路仿真工具Multisim及其应用 2.1 主界面及其设置 2.2 电原理图的创建 2.3 虚拟仪表的使用方法 2.4 基本分析方法 2.5 仿真结果的后续处理 2.6 仿真实例 2.7 习题第2篇 电子系统的可编程设计技术 第3章 可编程逻辑器件(PLD)的原理与应用 3.1 简单可编程逻辑器件 3.2 高密度可编程逻辑器件 3.3 常用可编程逻辑器件及其开发工具 3.4 Altera可编程器件的开发MAX+plusII 3.5 实计实例 3.6 习题 第4章 可编程模拟电路(PAC)的原理及应用 4.1 可编程模拟电路概述 4.2 ispPAC系列器件的结构 4.3 ispPAC器件开发工具 4.4 设计实例 4.5 数模混合可编程单片系统简介 4.6 习题第3篇 印制电路板设计技术 第5章 印制电路板(PCB) 5.1 印制电路板基本知识 5.2 自动布局布线 5.3 Protel99SE概述 5.4 用Protel99SE设计原理图 5.5 用Protel99SE设计印制 5.6 习题第4篇 专用集成电路设计技术 第6章 集成电路制造工艺与专用 6.1 集成电路制造工艺简介 6.2 CMOS基本单元电路 6.3 专用集成电路设计过程 6.4 专用集成电路设计的EDA技术 6.5 习题 第7章 集成电路设计工具Microwind与DSCH 7.1 Microwind的主要功能 7.2 Microwind的版图综合 7.3 习题附录 逻辑符号对照表参考文献

<<电子设计自动化技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>